

导电胶 ECA10

Electronic Conductive Adhesive ECA10

产品概述

ECA10 是一款单组份环氧导电银胶，适用于高速施胶工艺，固化后产品具有高导电、导热特性和高可靠性等特点。典型应用包括半导体封装的晶片贴装，LED 芯片的固晶粘接，以及其他需要导电粘接的场合。

注意：使用前须先将针筒垂直放置以达到室温，切勿重复冻结。

固化前产品特性

外观	银灰色粘稠液体
粘度 (Brookfield CP52, mPa.s(cP))	8000
密度 (ASTM D792, g/cm ³)	3.5
触变指数 (粘性@0.5/粘性@5rpm, 1/10rpm)	7.2
常温使用寿命 (25°C, 天)	14
存储寿命 (-40°C, 天)	365
F 含量 (ppm)	ND
Cl 含量 (ppm)	ND
Br 含量 (ppm)	ND
I 含量 (ppm)	ND

产品固化条件

175°C	1 小时
替代固化条件	3~5 分钟升温至 175 C 再恒温 1 小时

固化后产品特性

项目	测试方法	单位	数值
玻璃化温度 (T _g)	TMA	°C	103
热膨胀系数 T _g 以下	TMA	ppm/°C	55
热膨胀系数 T _g 以上	TMA	ppm/°C	150
导热系数	Laser Flash	W/mK	2.4
体积电阻	--	Ohm/cm	<=0.0005
热失重	TGA @300°C	%	0.19
饱和吸水率	85 °C/85RH	%	0.6
剪切强度	2*2mm Si die on Ag/Cu LF	Kg (25°C)	>=4.5
剪切强度	2*2mm Si die on Ag/Cu LF	Kg (150°C)	>=1.5
剥离强度	Al/Al	N/mm ²	7

产品包装及货期

包装	17.5g、35g 针管
最小包装量 (MPQ)	5CC
最小订单量 (MOQ)	5CC
交货期 (L/T)	10-20 个工作日